

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	中大君悦：陈修能、曲芳；东吴证券：刘玥娇；彤源：麦世学；农银汇理基金：张璋；华宝信托：张卿隆；太平养老：张凯；华源电子：熊宇翔；弘毅远方：陈祥辉；源乐晟：吴雨哲；博衍基金：卢湛
时间	2026 年 1 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、公司概况</div> <p>通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。</p>

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度分别实现营收 214.29 亿元、222.69 亿元、238.82 亿元和 201.16 亿元。公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度的归母净利润分别为 5.02 亿元、1.69 亿元、6.78 亿元和 8.60 亿元。

二、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：请问本次向特定对象发行股票对拓展客户有什么好处吗？

回复：公司是全球半导体封测领域的领先企业，营收规模及市场占有率全球排名第四、国内排名第二。长期以来，公司的发展与全球及国内半导体产业保持同频，在 AI、高性能计算、移动智能终端、工业控制、车载电子等领域积累了广泛的行业客户基础，包括 AMD、德州仪器、恩智浦、联发科、展锐、艾为、卓胜微、集创北方、比亚迪、纳芯微等。作为产业链关键一环，公司持续推动关键封测能力的升级，通过高良率、高可靠性封测工艺

保障下游芯片性能兑现与规模化交付，在重塑全球集成电路制造格局、加速创新技术产业化方面发挥了重要支撑作用。本次公司向特定对象发行股票募集资金，主要投向下游高景气度、国产替代加速、技术密集的增长领域，提升现有产能规模与供给弹性，以更好地承接下游市场复苏及结构性增长机遇，为国内外龙头客户提供更稳健的本土化封测支撑，并为承接新兴优质客户奠定产能基础，巩固公司在全球封测产业的领先地位。

问题 3：本次发行的发行时间是什么时候？

回复：本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

问题 4：公司本次发行“晶圆级封测产能提升项目”具体的项目计划是什么？

回复：本项目计划投资 74,330.26 万元提升晶圆级封测等产能，新增晶圆级封测产能 31.20 万片，同时亦提升该厂区高可靠性车载品封测产能 15.732 亿块。本项目实施将有助于发行人扩大晶圆级封装等先进封装实力，促进公司向下游客户提供完整解决方案，优化产品结构，进一步增强公司在行业中的竞争力及影响力。

问题 5：请简单分析一下汽车领域下游市场空间情况。

回复：当前，全球汽车产业正经历“电动化、智能化、网联化”的变革，新能源汽车市场呈现爆发式增长。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量已由 2019 年的 120.6 万辆提升至 2024 年的 1,286.6 万辆，新能源汽车的市场占有率已超过 40%，2022 年到 2024 年我国新能源汽车市场年均销量增长率超过 36%。

随着新能源汽车渗透率的提升，市场对汽车芯片的需求量也大幅提升。以车规 MCU 为例，智能化的发展趋势推进车载芯片功能的复杂度提升，MCU 在智能座舱、车身控制、车载娱乐等基础系统的应用基础上，目前已广泛延伸至动力控制、底盘域及 ADAS 等高安全性、高实时性的关键功能模块，对 MCU 的算力、接口能力、功能安全等级提出更高要求。随着电动车与智能汽车渗透率提升，单车 MCU 价值量亦显著提升。基于上述发展趋势，近年来车载芯片市场规模快速提升。根据 Omdia 的数据和预测，2024

	<p>年全球车规级半导体市场规模约为 721 亿美元，2025 年将达到 804 亿美元，增长率为 11.51%；2024 年中国车规级半导体市场规模约为 198 亿美元，2025 年将达到 216 亿美元，增长率为 9.09%。</p> <p>问题 6：2025 年整体业绩情况如何？</p> <p>回复：公司已于 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露《2025 年度业绩预告》，2025 年度预计归属于上市公司股东的净利润为 110,000 万元-135,000 万元，预计同比增长 62.34%-99.24%；2025 年度预计扣除非经常性损益后的净利润为 77,000 万元-97,000 万元，预计同比增长 23.98%-56.18%，变动原因主要系 2025 年内，全球半导体行业呈现结构性增长，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显着提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2025 年业绩。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 29 日